

每週半導體新聞

2026年6月5日~6月11日

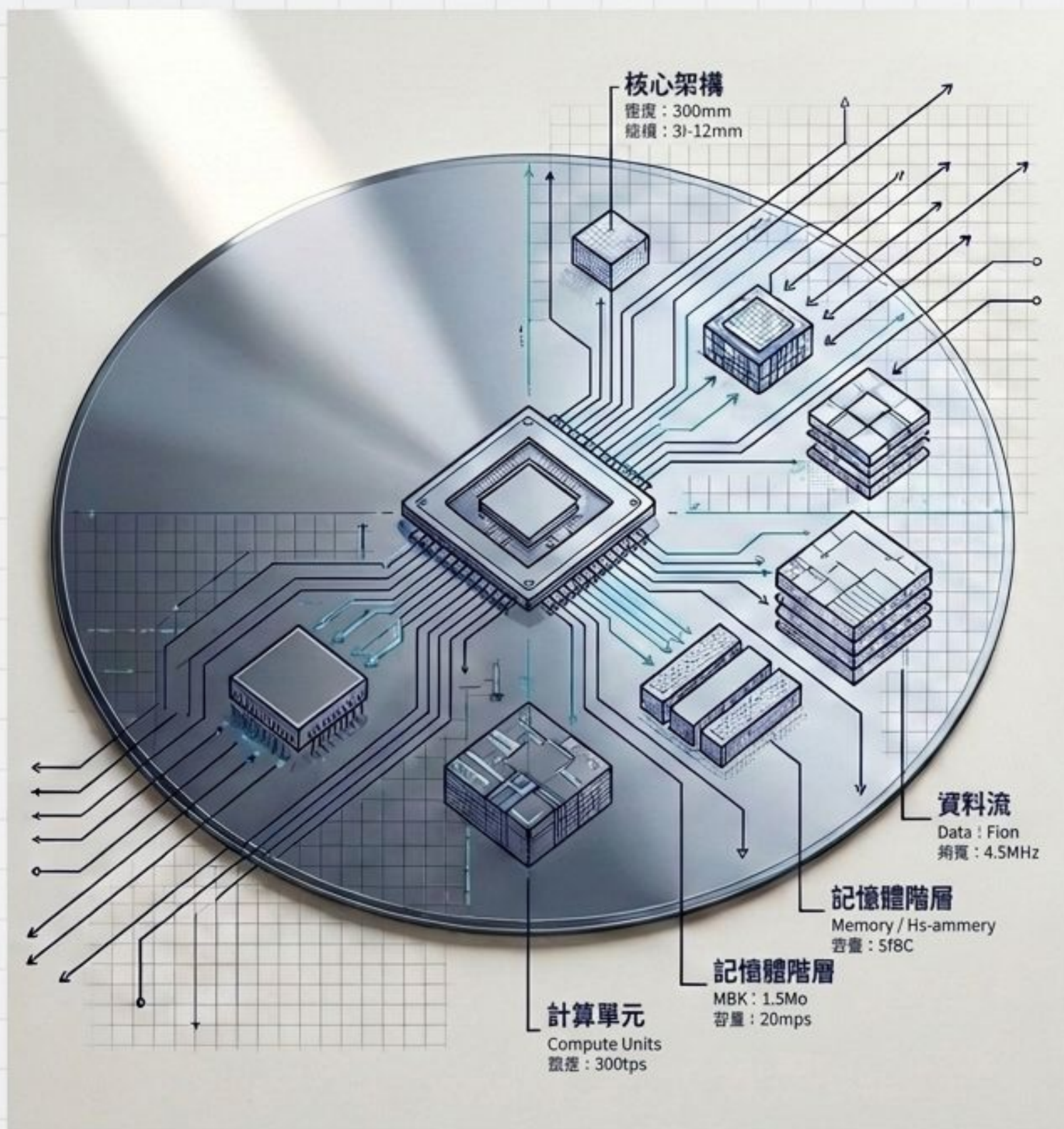
Miki Matsui
共同創辦人，CHIP-J

AI熱潮帶來的計算需求爆炸性增長，暴露了傳統摩爾定律的局限性，迫使半導體產業進行結構性的範式轉移。下一代矽晶片正超越單純的微縮化，演變為透過小晶片技術、先進封裝以及專用AI加速器整合而成的異質架構。

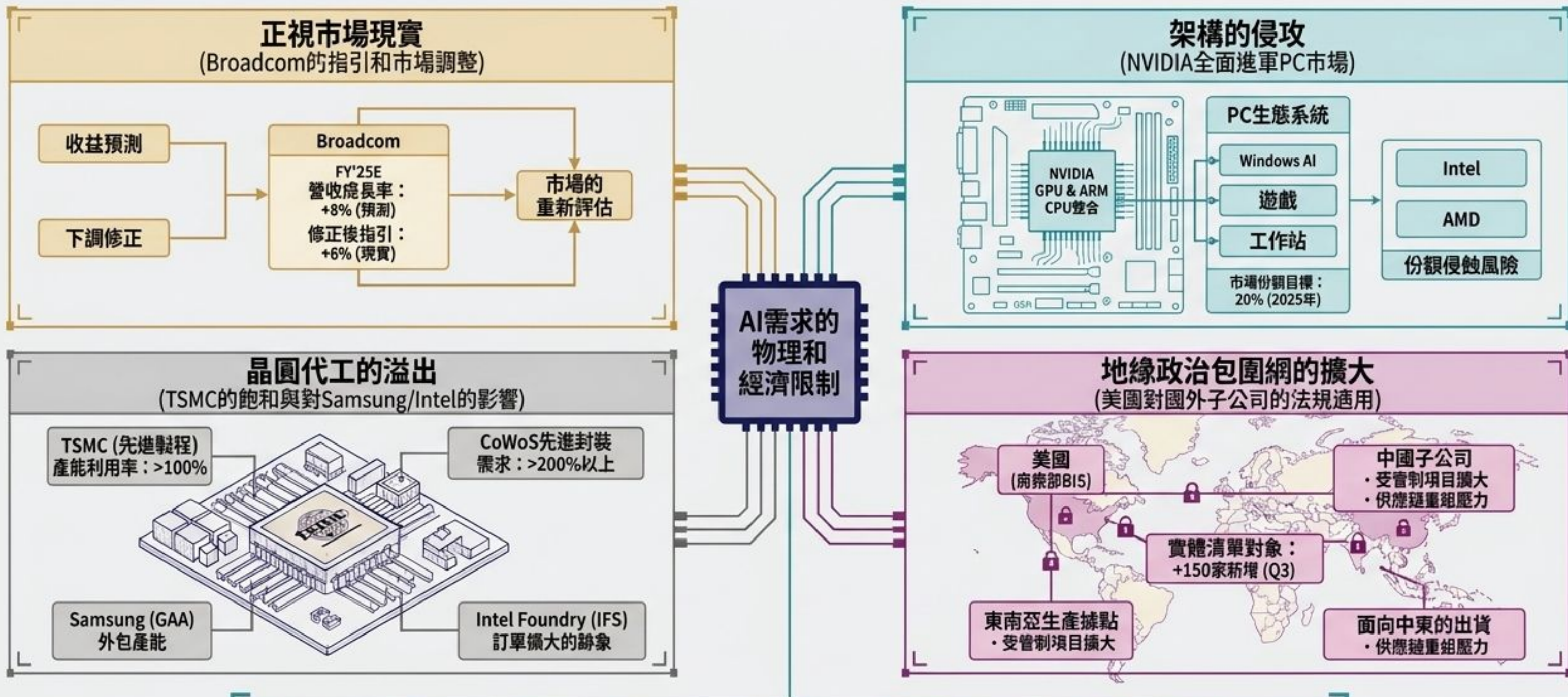
【結構性瓶頸】
先進製程的製造能力有限，地緣政治緊張局勢加劇了供應鏈的脆弱性。這成為加速市場重組的因素。

【結構性瓶頸】
先進製程的製造能力有限，地緣政治緊張局勢加劇了供應鏈的脆弱性。這成為加速市場重組的因素。

【市場動態】
預計到2026年，AI專用晶片市場規模將翻倍，隨之而來的是對實現記憶體（HBM）和高頻寬互連的投資急劇增加。這將成為半導體版圖的新前沿。



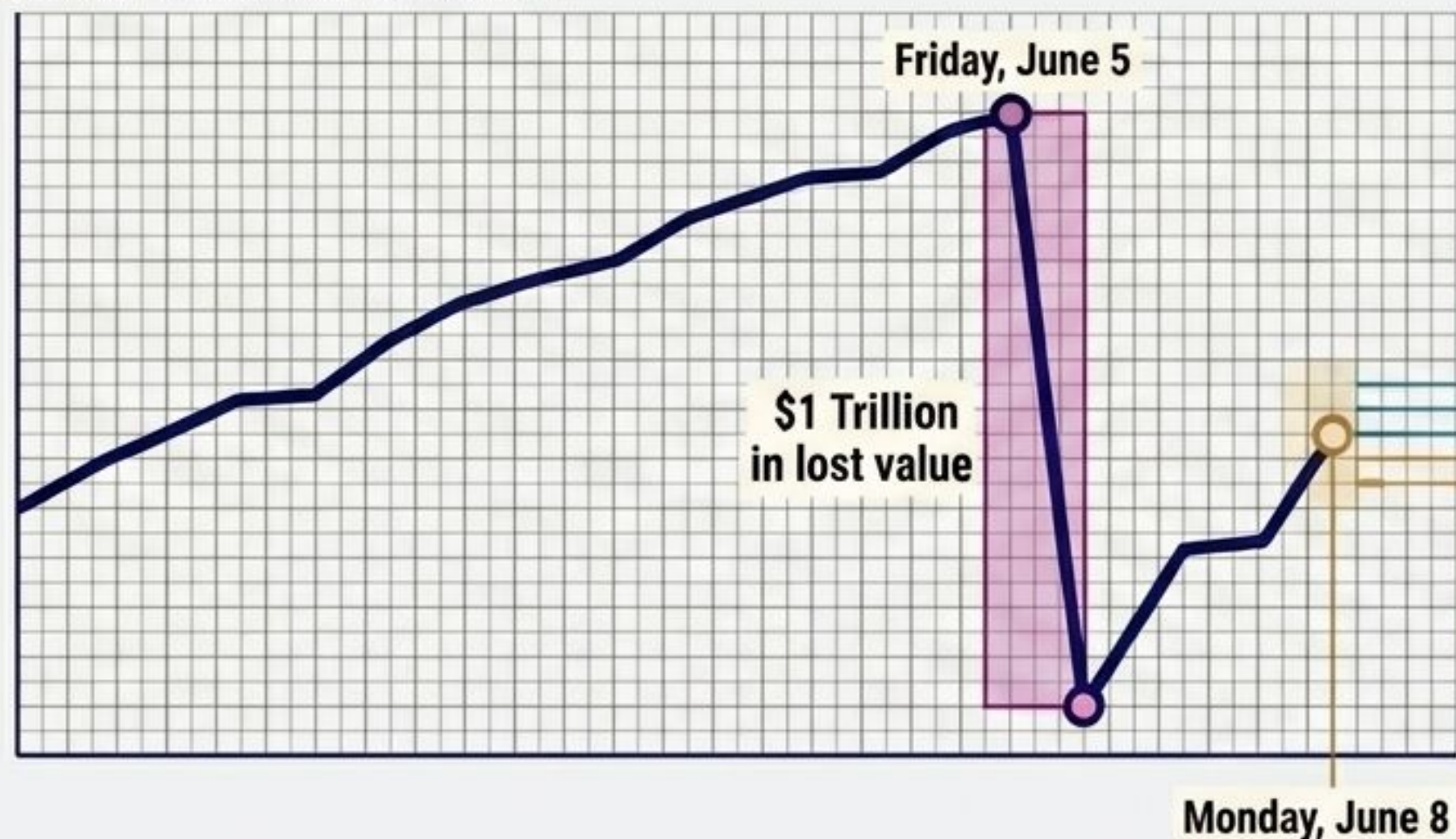
面臨物理和經濟限制的AI需求對整個生態系統的影響



本週劇烈的市場波動和行業動態可歸結為一個主題。「AI的無限需求」情景與現實的產能和指引發生衝突，迫使整個行業進行強制性適應。

從無限的AI成長預期轉向嚴格的基本面評估

Editorial Financial Timeline



Diagnostic Layout - Expectation vs. Reality



Broadcom Shock:

成為瓦解市場「AI無限成長」情境的觸發點。

Collateral Damage:

Marvell下跌約16%，Micron下跌約13%。

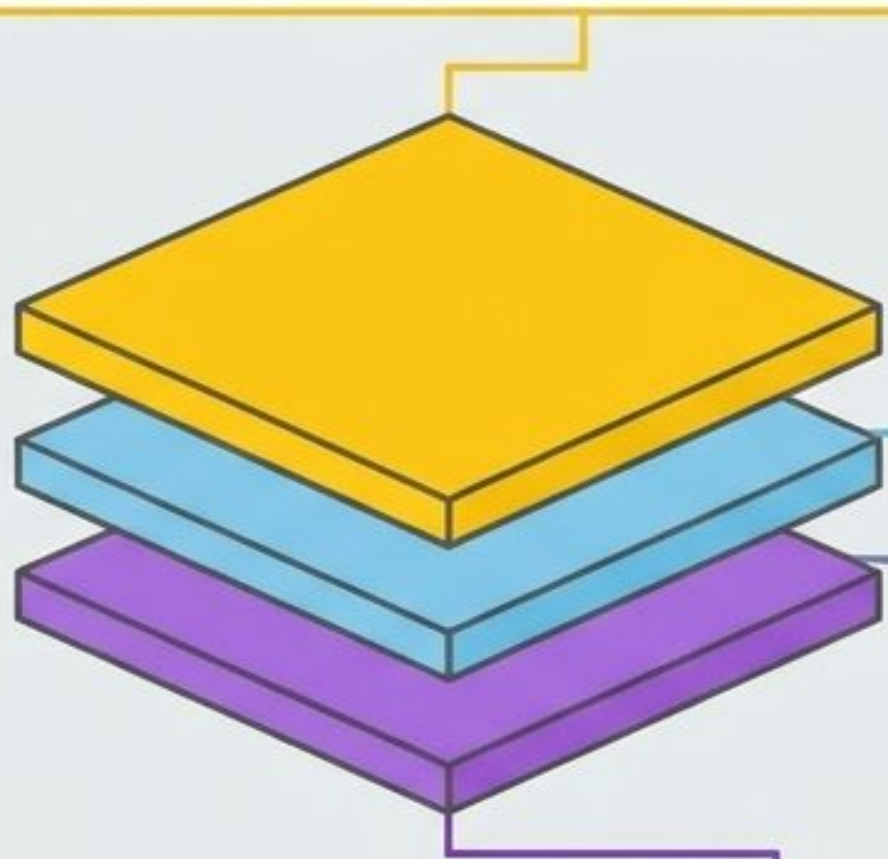
The Rebound:

週一（6月8日）Micron反彈約10%，市場轉向基於基本面的重新評估模式。

數據中心霸主入侵客戶端及邊緣領域

The PC Invasion (New Front):

發布 Arm 架構筆記型/桌上型超級晶片「RTX Spark」。



Strategic Partnerships:

透過與 MediaTek 共同開發，實現 Windows on Arm 環境。預計搭載於 Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface 等主要硬體。

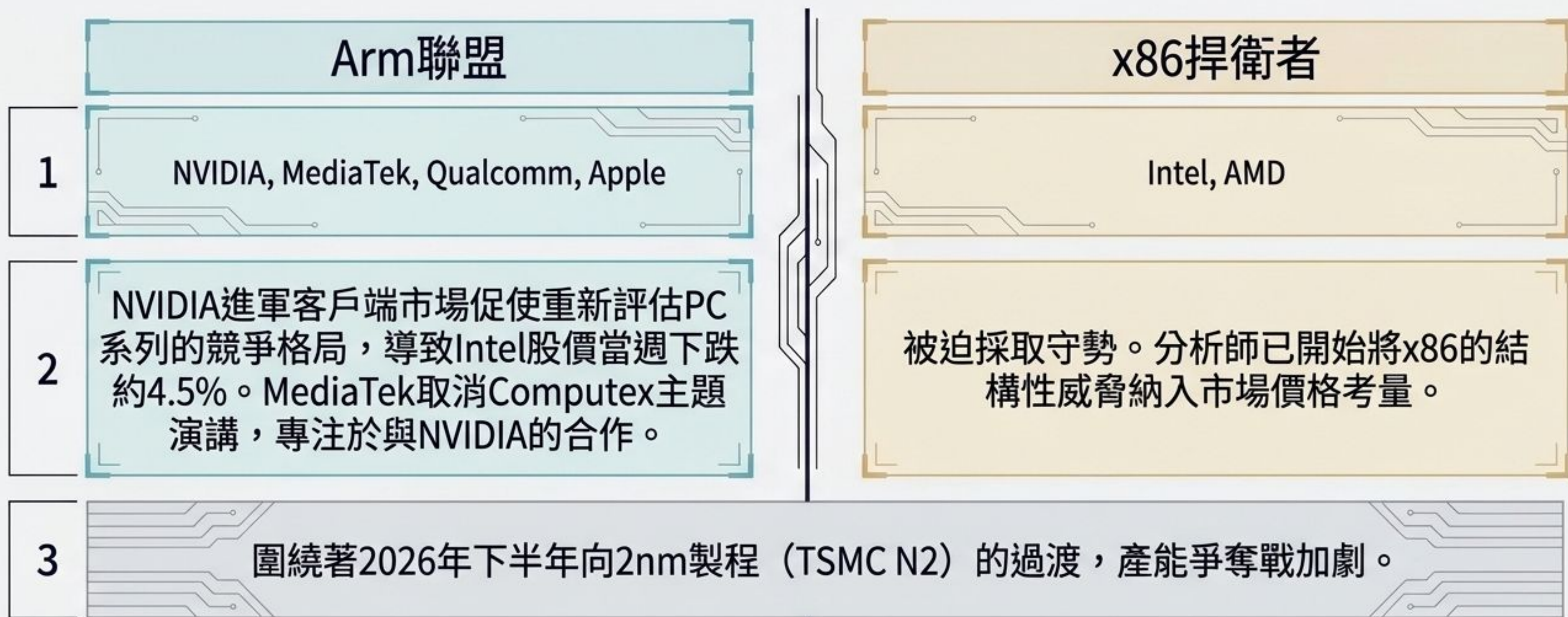
Strategic Insight Block:

僅稱霸數據中心已不夠。NVIDIA 正建立端到端的 AI 堆疊，對 Intel、AMD、Qualcomm 的主力市場構成直接威脅。

Data Center Core (Established Hegemony):

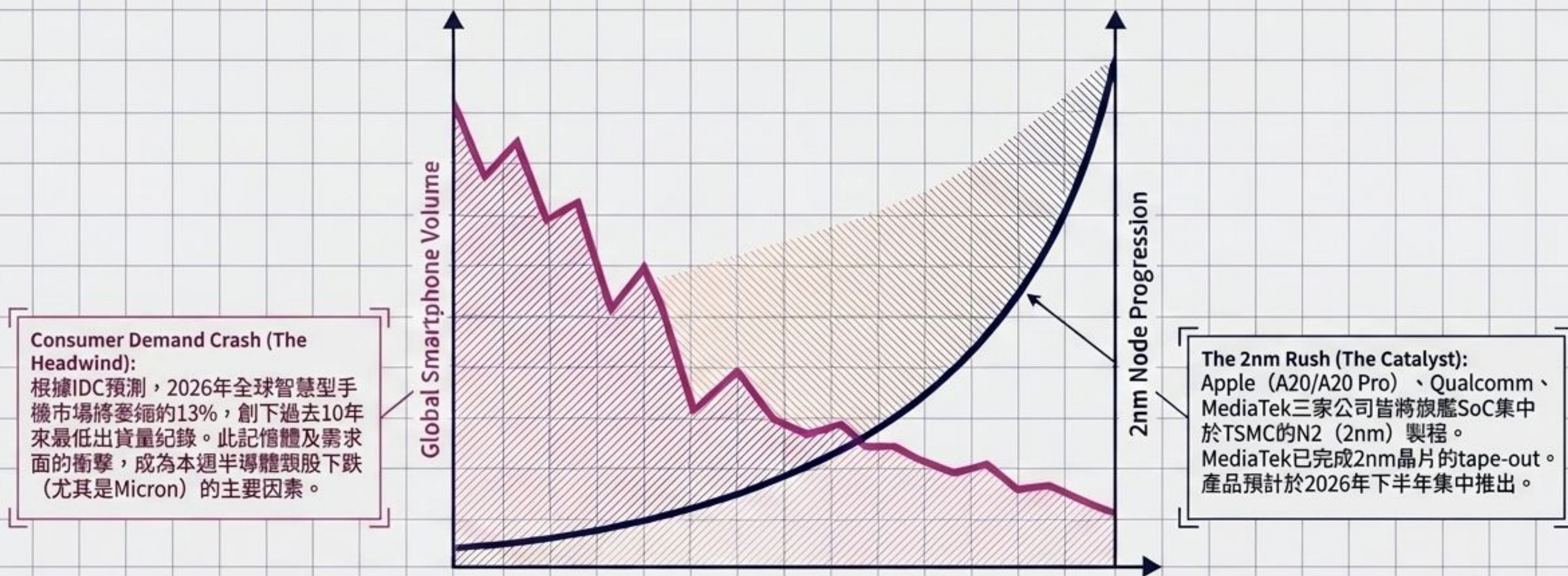
Vera CPU 已達全面生產。OpenAI、Anthropic、SpaceX 列為初期採用企業，獨占 AI 堆疊的基礎。

新興PC架構霸權之爭的生態系分歧



客戶端運算的主要戰場，正從單純的晶片效能競爭，轉移到涉及OS（Windows on Arm）的架構生存競爭。

歷史性需求減退與對次世代2nm製程依賴之兩難困境



在需求急劇下降的情況下，晶片製造商為了促使消費者升級，不得不將一切押注於伴伴隨龐大成本的2nm壓倒性性能提升上。

TSMC的產能飽和引發流向替代晶圓廠的『外溢』



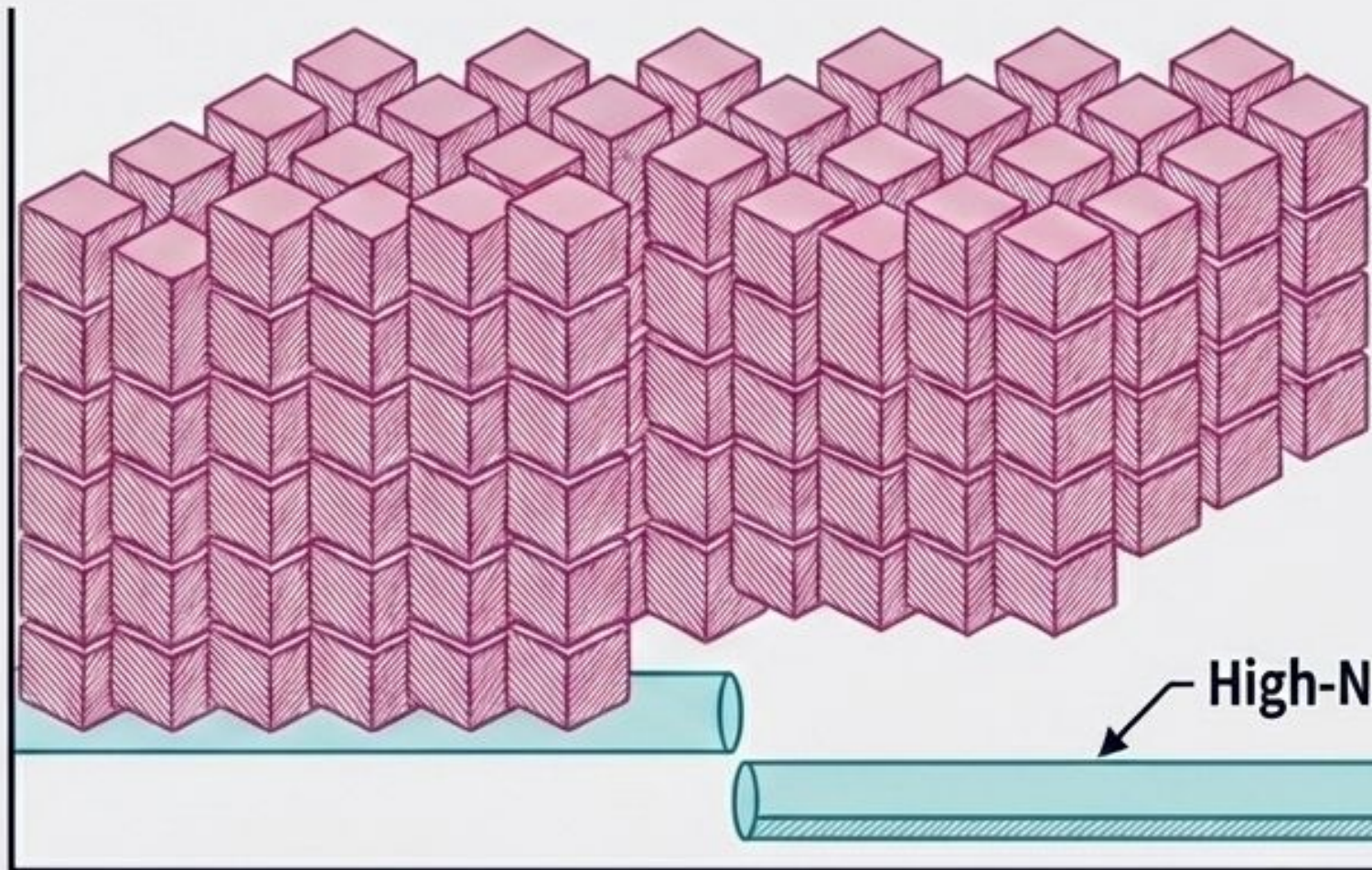
三星的復甦：隨著良率和稼動率的改善，目標在2026年第三季實現盈利。獲得了Groq的加速器和輝達的自動駕駛晶片（4nm/8nm）等『外溢』的AI晶片項目。三星高層Jun Young-hyun在首爾會見了黃仁勳，深化了合作。

台積電的瓶頸：台積電的最先進製程因AI加速器需求事實上已『完售』。就連蘋果也被迫尋求次世代A21晶片的第二供應來源，同時從亞利桑那工廠調度1億顆以上晶片至年底。

英特爾的機會：以台積電的供應限制為背景，與蘋果展開了初期階段的協商。

勒緊所有晶圓代工廠的光刻供應鏈物理限制

Late 2027



EUV 積壓訂單

創紀錄的約 45 台 EUV 系統積壓訂單。
來自台積電、三星、英特爾三家公司針對 2nm 及以下節點的訂單同時湧入。

High-NA 限制

下一代 High-NA EUV 系統的產能仍然限制在每年不到 20 台。

戰略洞察

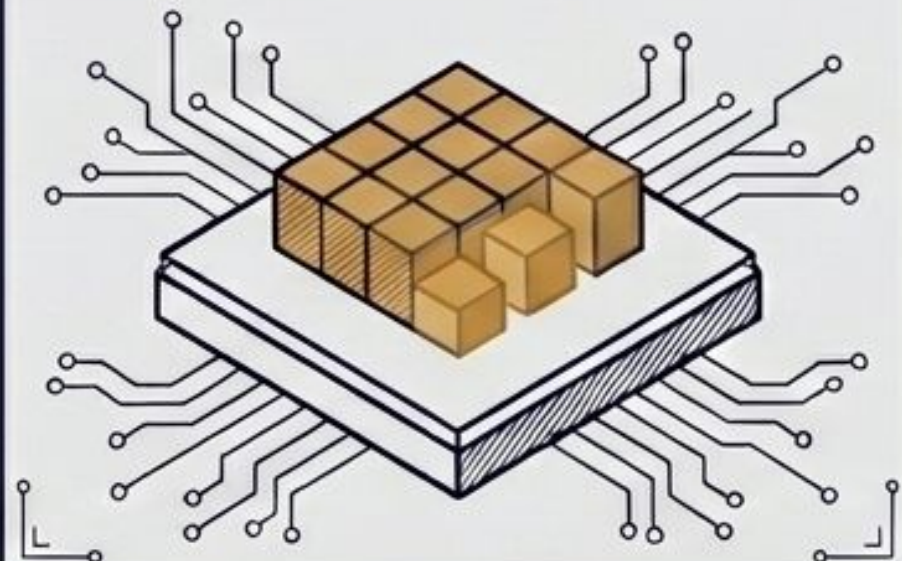
儘管晶圓代工廠之間的競爭日益激烈，但台積電、三星、英特爾三家公司都受困於 ASML 這一單一供應鏈的物理限制。預計積壓訂單的消化將推遲到 2027 年下半年。

三方角力晶圓代工競爭中各公司的戰略定位

TSMC (The Capacity King)

Share: 73% (截至Q1, 從上一季的72%擴大)

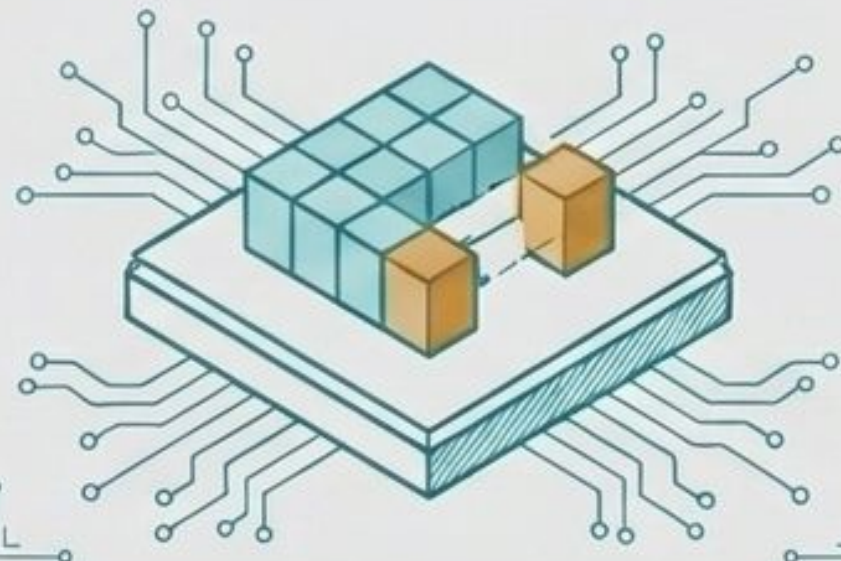
Status: 產能完全飽和。這反常地成為向競爭對手敞開大門的因素。



Samsung Foundry (The Rebound Challenger)

Share: 約7%

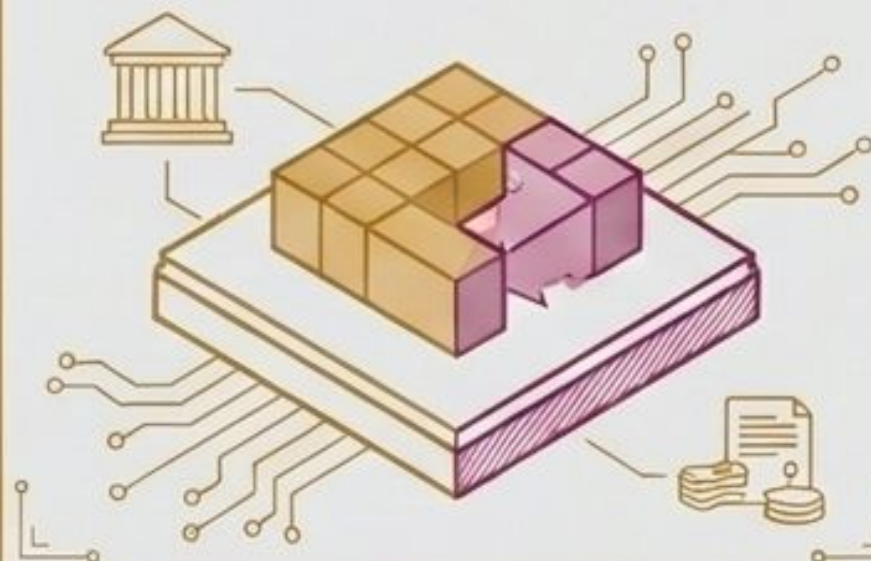
Status: 承接來自TSMC的溢出需求。透過良率改善和NVIDIA/Groq等的新訂單，目標在Q3實現轉虧為盈。



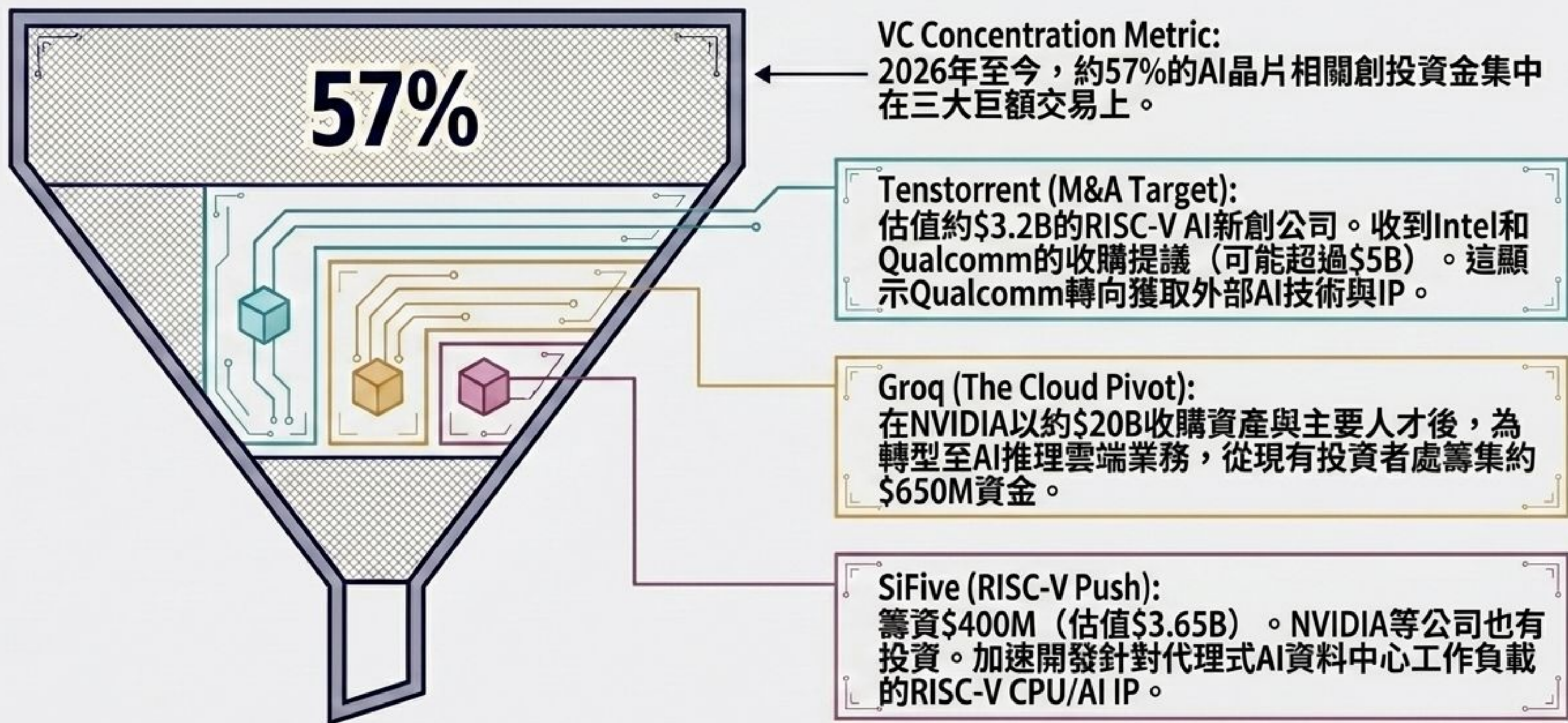
Intel Foundry (The Sovereign Play)

Share: (N/A - 內部轉型)

Status: CHIPS法案資金和美國政府的強力支持。與Apple的初步討論，以及試圖打入次世代生態系統。



NVIDIA替代生態系統的資金集中與重組加速



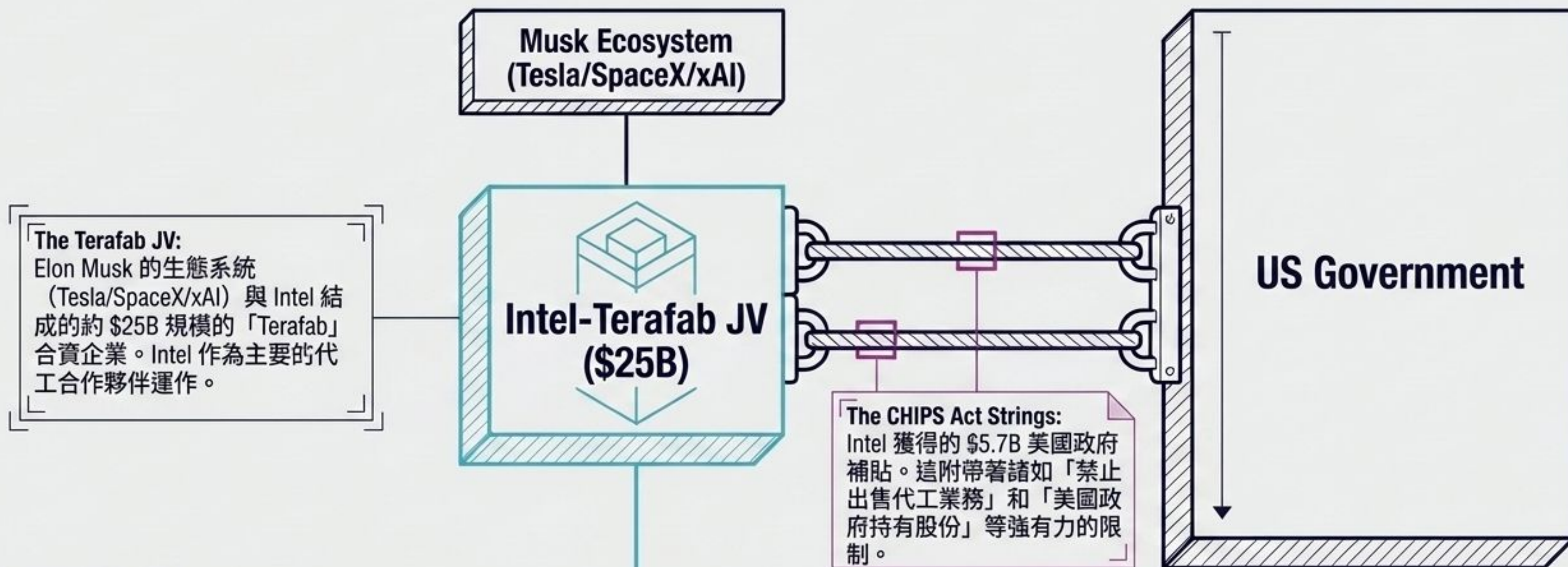


域外效力:
華盛頓特區的達維斯法案
正確地將美國法律延伸至
馬霍拉坎組件和麵板領域

關稅與許可:
華盛頓特區通過關稅
和許可制度來緩解關
稅影響

科技霸權之爭...

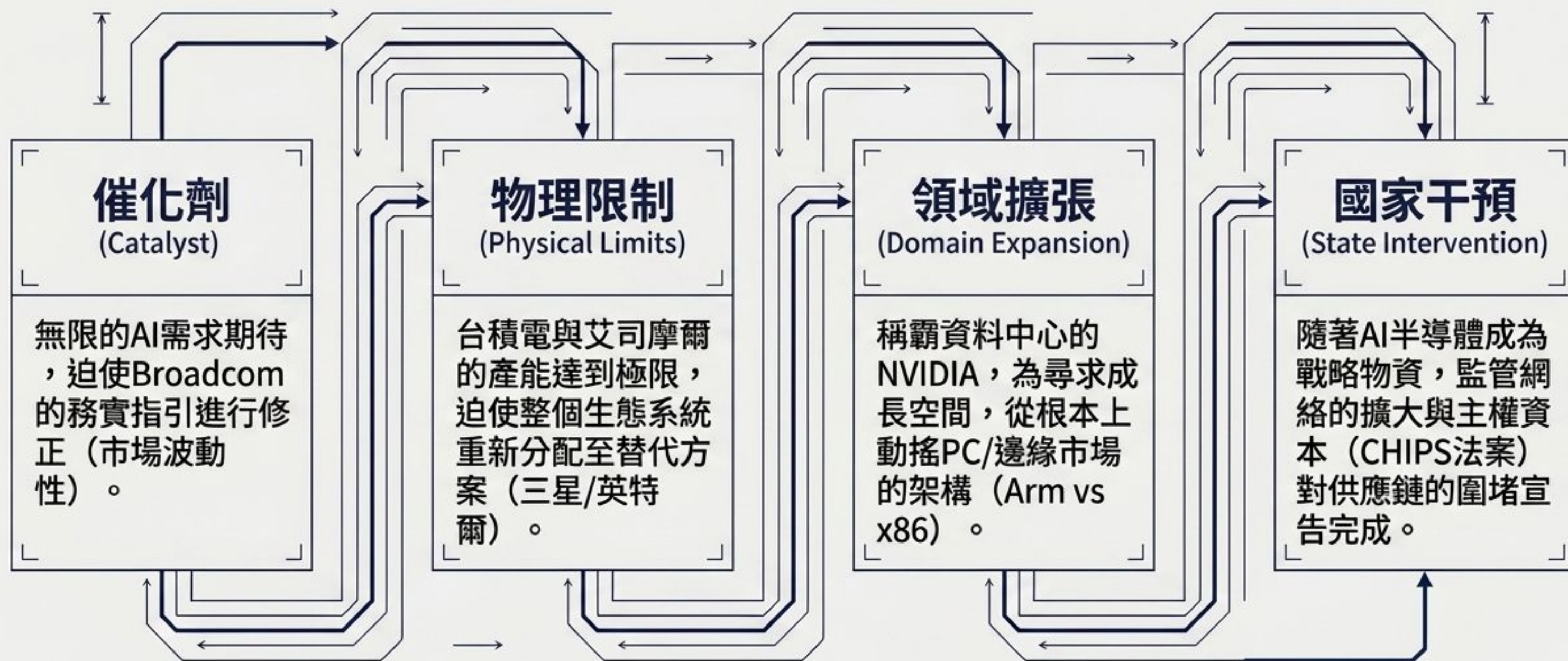
主權基礎設施化的尖端代工廠的資本與政治聯繫



Synthesis Block

尖端代工廠不再僅僅是私人企業。它已轉變為與國家安全深度關聯的「高度受監管的主權基礎設施」，這也是 Intel 股價急飆升（年初至今增長約 250%）的背景。

貫穿一系列市場變動的單一法則：「AI的漣漪效應」



給日本市場利益相關者的三個戰略啟示

1

Takeaway 1: 探索「溢出」市場的投資機會

在台積電（TSMC）單極集中達到極限的現在，三星晶圓代工的生態系統，以及作為替代方案的RISC-V/AI新創公司（如Tenstorrent等）的周邊供應鏈中正在產生新的價值。

2

Takeaway 2: 為2026年下半年的「客戶端架構戰爭」做好準備

隨著2nm製程的興起，NVIDIA/Arm聯盟與Intel/AMD（x86）之間的衝突將在PC市場全面展開。相關零組件企業需要具備能夠迅速應對兩大陣營力量關係變化的體制。

3

Takeaway 3: 適應納入地緣政治風險的「主權基礎設施」

美國政府擴大監管網絡以及《晶片法案》（CHIPS Act）提供的附帶條件資金（如Intel/Terafab等），決定了供應鏈的斷裂。加強合規監控和構建「地緣政治上安全」的採購網絡是當務之急。

本簡報的基礎資訊來源與資料結構

Markets & Finance

CNBC

Bloomberg

TheStreet

Yahoo Finance

Crypto Briefing

Supply Chain & Foundry

TrendForce

DigiTimes

Republic World

RivCut

Technology & Hardware

TweakTown

wccftech

VideoCardz

Tom's
Hardware

DCD /
SiliconANGLE

Startup & VC Intelligence

TechCrunch

New Market
Pitch

Semiconductor
Engineering

Policy & Geopolitics

Al Jazeera

Mayer Brown

Morgan Lewis

SIA / Business
Wire

Intel
Newsroom

[Data synthesized from Semiconductor Weekly Digest – June 5–11, 2026]